

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-242989

(P2013-242989A)

(43) 公開日 平成25年12月5日(2013.12.5)

(51) Int.Cl.
H01R 11/01 (2006.01)F1
H01R 11/01

テーマコード (参考)

Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2012-114073 (P2012-114073)
(22) 出願日 平成24年5月18日 (2012.5.18)(71) 出願人 591124374
千代田インテグレ株式会社
東京都中央区明石町4番5号
(74) 代理人 100077827
弁理士 鈴木 弘男
(72) 発明者 吉田 正樹
東京都中央区明石町4番5号 千代田イン
テグレ株式会社内

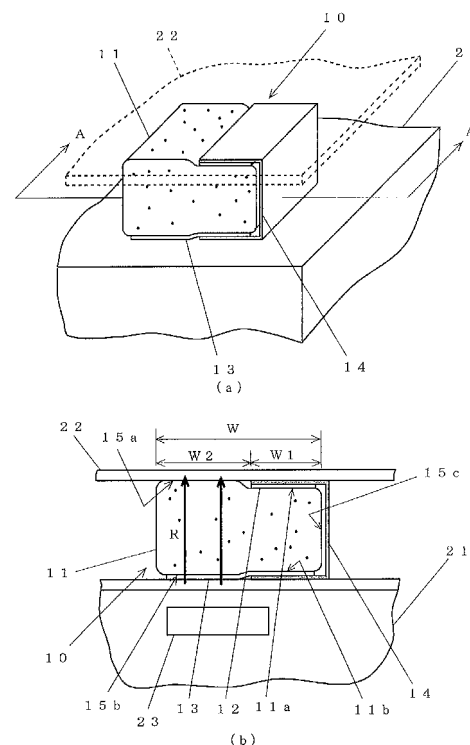
(54) 【発明の名称】 導電伝熱ガスケット

(57) 【要約】

【課題】取り付けられる隙間にクッション性を持たせ電気的に導通すると共に伝熱性の機能を備えた導電伝熱ガスケットを提供すること。

【解決手段】 本発明の導電伝熱ガスケット10は、矩形体状のクッション本体11と、クッション本体11の互いに平行な面の一方の面においてクッション本体11の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層12と、クッション本体11の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層13と、粘着層12と、熱伝導性粘着層13の粘着層12と対向する領域と、クッション本体11の一方の側面とを覆い貼り付けられた導電フィルム14とを備えることとした。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備えたことを特徴とする導電伝熱ガスケット。

【請求項 2】

矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記熱伝導性粘着層は、前記導電体が貼り付けられる前記粘着層と対向する領域を上回り前記他方の面の面積を下回る予め定めた領域に設けられることを特徴とする導電伝熱ガスケット。

10

【請求項 3】

矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面と他方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記クッション本体は、自己粘着性を有するクッション材で形成したことを特徴とする導電伝熱ガスケット。

20

【請求項 4】

前記粘着層の前記予め定めた領域と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域とは、それぞれ前記クッション本体の前記平行な面の半分を占めることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の導電伝熱ガスケット。

【請求項 5】

前記クッション本体は、熱伝導率の高い材料を使用し、前記熱伝導率の高い材料として、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだエチレンプロピレン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだウレタン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだ熱可塑性エラストマー、熱伝導性フィラーを含んだ樹脂発泡体、ソフトフェライト含有樹脂、グラファイト含有ゴム、グラファイトのいずれかの材料とすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の導電伝熱ガスケット。

30

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、電子関連製品において電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に伝熱性の機能を備えた導電伝熱ガスケットに関する。

【背景技術】**【0002】**

携帯電話やパソコンなどの電子関連製品においては、電気導体（小型電子部品）間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に導通し同一レベルにすることが導電ガスケットにより行なわれている（例えば、特許文献 1 参照）。

40

【0003】

しかしながら、従来の導電ガスケットは、平行な二面が形成された直方体状のクッション本体と、クッション本体の上記二面を両面粘着テープを介して覆うとともに上記二面の一方の側面を覆う導電体の導電フィルムとにより構成されており、電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間をクッション性を持たせ電氣的に導通することが行なわれているが、小型電子部品でもある電気導体に発熱性のものが設けられていた場合、導電フィルムにより放熱が遮断され伝熱が行なわれないため、小型電子部品の放熱効果を効果的に得るためには導電ガスケットに伝熱性の機能が望まれているという問題があった。

50

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2008-258020号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであって、電子関連製品において電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に導通すると共に伝熱性の機能を備えた導電伝熱ガスケットを提供することを目的とする。

10

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備えることとした。

【0007】

また、本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記熱伝導性粘着層は、前記導電体が貼り付けられる前記粘着層と対向する領域を上回り前記他方の面の面積を下回る予め定めた領域に設けられることとした。

20

【0008】

また、本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面と他方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記クッション本体は、自己粘着性を有するクッション材で形成することとした。

30

【0009】

また、前記粘着層の前記予め定めた領域と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域とは、それぞれ前記クッション本体の前記平行な面の半分を占めることとした。

【0010】

さらに、前記クッション本体は、熱伝導率の高い材料を使用し、前記熱伝導率の高い材料として、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだエチレンプロピレン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだウレタン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだ熱可塑性エラストマー、熱伝導性フィラーを含んだ樹脂発泡体、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゲル、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゲル、ソフトフェライト含有樹脂、グラファイト含有ゴム、グラファイトのいずれかの材料とすることとした。

40

【発明の効果】

【0011】

本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備えることとした。

50

ため、取り付けられる電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱効果を効果的に得ることができる。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域に設けられた粘着層と、前記クッション本体の互いに平行な面の他方の面に設けられた熱伝導性粘着層と、前記粘着層と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記熱伝導性粘着層は、前記導電体が貼り付けられる前記粘着層と対向する領域を上回り前記他方の面の面積を下回る予め定めた領域に設けられることとしたため、取り付けられる電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱効果をより効果的に得ることができる。

10

【 0 0 1 3 】

また、本発明の導電伝熱ガスケットは、矩形体状のクッション本体と、前記クッション本体の互いに平行な面の一方の面と他方の面において前記クッション本体の一方の側面から予め定めた領域と、前記クッション本体の前記一方の側面とを覆い貼り付けられた導電体とを備え、前記クッション本体は、自己粘着性を有するクッション材で形成することとしたため、取り付けられる電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱効果を簡潔構造でより効果的に得ることができる。

20

【 0 0 1 4 】

また、前記粘着層の前記予め定めた領域と、前記熱伝導性粘着層の前記粘着層と対向する領域とは、それぞれ前記クッション本体の前記平行な面の半分を占めることとしたため、電氣的に安定して導通する導電性と放熱効果を的確に得ることができる。

【 0 0 1 5 】

さらに、前記クッション本体は、熱伝導率の高い材料を使用し、前記熱伝導率の高い材料として、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだエチレンプロピレン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだウレタン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだ熱可塑性エラストマー、熱伝導性フィラーを含んだ樹脂発泡体、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゲル、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゲル、ソフトフェライト含有樹脂、グラファイト含有ゴム、グラファイトのいずれかの材料とすることとしたため、放熱効果をよりの確に得ることができる。

30

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 1 6 】

【 図 1 】本発明の第 1 の実施の形態の導電伝熱ガスケットの図を示し、図 1 (a) は、導電伝熱ガスケットが設置されたときの斜視図を示し、図 1 (b) は、導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

【 図 2 】本発明の第 2 の実施の形態の導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

【 図 3 】本発明の第 3 の実施の形態の導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

40

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 1 7 】

以下、本発明の実施の形態の導電伝熱ガスケットにつき説明する。

【 実施例 1 】

【 0 0 1 8 】

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態の導電伝熱ガスケットの図を示し、図 1 (a) は、導電伝熱ガスケットが設置されたときの斜視図を示し、図 1 (b) は、導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

【 0 0 1 9 】

図 1 (a) に示すように、本発明の第 1 の実施の形態の導電伝熱ガスケット 1 0 は、基

50

材としてクッション本体 11 を使用するためクッション性があり、小型電子部品でもある電気導体 21 とアース基板 22 との間の隙間に設けられ、熱伝導性粘着層 13 により電気導体 21 に止められるとともに電気導体 21 とアース基板 22 との間に圧縮され保持されている。

【0020】

また、詳細は後述するがクッション本体 11 の特定部が導電フィルム 14 で覆われ、導電フィルム 14 は電気導体 21 とアース基板 22 とに接触する。

【0021】

従って、導電伝熱ガスケット 10 は、クッション性を有し電気導体 21 とアース基板 22 との間の隙間に電氣的に導通して設けられ、電気導体 21 とアース基板 22 との間の隙間に変動があったとしても電氣的な導通性が損なわれることはない。

10

【0022】

図 1 (b) は、図 1 (a) の A A 断面図を示し、導電伝熱ガスケット 10 は、基材のクッション本体 11 と、クッション本体 11 の段差部 11a が形成された上側の面 15a に設けられた粘着層 12 と、クッション本体 11 の段差部 11b が形成された下側の面 15b に設けられた熱伝導性を有する熱伝導性粘着層 13 と、クッション本体 11 の特定部とを覆う導電フィルム 14 とで構成され、電気導体 21 とアース基板 22 との間の隙間に圧縮され保持されている。

【0023】

クッション本体 11 は、上側の面 15a と下側の面 15b とが平行に形成された幅 W の矩形体状となっており、クッション性と熱伝導率の高い材料を使用する。

20

【0024】

クッション本体 11 に使用する熱伝導率の高い材料として、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだエチレンプロピレン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだウレタン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゴム、熱伝導性フィラーを含んだ熱可塑性エラストマー、熱伝導性フィラーを含んだ樹脂発泡体、熱伝導性フィラーを含んだアクリル系ゲル、熱伝導性フィラーを含んだシリコン系ゲル、ソフトフエライト含有樹脂、グラファイト含有ゴム、グラファイトなどを使用することができる。

【0025】

粘着層 12 は、クッション本体 11 の一方の端部側の側面 15c から上側の面 15a の段差部 11a 内の予め定めた幅 W1 の領域に設けられる。そのため、クッション本体 11 は、全幅 W から予め定めた幅 W1 を差引いた幅 W2 の領域で上側の面 15a がアース基板 22 に押当てられ、幅 W2 の領域で下側の面 15b が熱伝導性粘着層 13 を介し電気導体 21 に止められている。

30

【0026】

熱伝導性粘着層 13 は、クッション本体 11 の下側の面 15b に設けられ、幅 W2 の領域で電気導体 21 に止められている。

【0027】

導電フィルム 14 は、合成樹脂製のフィルムの外側の面に金属層を形成した構造のものを使用し、クッション本体 11 の上側の面 15a に設けられた粘着層 12 と、粘着層 12 と対向する熱伝導性粘着層 13 の幅 W1 の領域と、クッション本体 11 の一方の端部側の側面 15c とを折曲げられて連続して覆い貼り付けられている。

40

【0028】

領域の幅 W1 は、上側の面 15a でも下側の面 15b でも導電フィルム 14 の幅を示し、領域の幅 W2 は、上側の面 15a ではクッション本体 11 がアース基板 22 に押当てられる幅を示し下側の面 15b でもクッション本体 11 が熱伝導性粘着層 13 を介し電気導体 21 に止められる幅を示し、領域の幅 W1 と領域の幅 W2 とを同じ幅に設定しているが、領域の幅 W1 と領域の W2 とは、導電フィルム 14 の導電性や熱伝導性粘着層 13 の粘着性や熱伝導性により自在に設定することもできる。

【0029】

50

導電伝熱ガスケット１０は、上記したごとく導電フィルム１４がクッション本体１１に折曲げられて連続して覆い貼り付けられ、電気導体２１とアース基板２２との間の隙間に電氣的に導通して設けられ、電気導体２１とアース基板２２との間の隙間に変動があったとしても電氣的な導通性が損なわれることはない。

【００３０】

また、導電伝熱ガスケット１０は、電気導体２１にコイルやＣＰＵなどの発熱体２３が設けられていたときには、その熱は矢印Ｒに示すように、熱伝導性粘着層１３と熱伝導率の高い材料を使用したクッション本体１１によりアース基板２２に伝達され、容易に放熱を行なうことができる。

【００３１】

以上、本発明の第１の実施の形態の導電伝熱ガスケットは、電子関連製品において電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱性の機能を備え、小型電子部品の放熱効果を効果的に得ることができる。

【００３２】

なお、クッション本体１１は、上側の面１５ａに段差部１１ａが形成され、下側の面１５ｂに段差部１１ｂが形成されているが、導電フィルム１４、粘着層１２、熱伝導性粘着層１３の状況により平面状にすることもできる。

【００３３】

また、粘着層１２と熱伝導性粘着層１３は両面テープのものを使用することもできる。

【００３４】

さらに、導電伝熱ガスケット１０は、電気導体２１とアース基板２２との間の隙間に設けることとしたが、電気導体２１間の隙間に設けるようにすることもできる。

【実施例２】

【００３５】

図２は、本発明の第２の実施の形態の導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

【００３６】

図２に示すように、本発明の第２の実施の形態の導電伝熱ガスケット１１０は、小型電子部品でもある電気導体１２１とアース基板１２２との間の隙間に設けられ、熱伝導性粘着層１１３により電気導体１２１に止められるとともに電気導体１２１とアース基板１２２との間で圧縮され保持されている。

【００３７】

導電伝熱ガスケット１１０は、基材のクッション本体１１１と、クッション本体１１１の段差部１１１ａが形成された上側の面１１５ａに設けられた粘着層１１２と、クッション本体１１１の段差部１１１ｂが形成された予め設定した下側の面１１５ｂに設けられた熱伝導性粘着層１１３と、クッション本体１１１の特定部とを覆う導電フィルム１１４とで構成され、電気導体１２１とアース基板１２２との間の隙間に圧縮され保持されている。

【００３８】

粘着層１１２は、クッション本体１１１の一方の端部側の側面１１５ｃから上側の面１１５ａの段差部１１１ａ内の予め定めた幅Ｗ１の領域に設けられる。そのため、クッション本体１１１は、全幅Ｗから予め定めた幅Ｗ１を差引いた幅Ｗ２の領域で上側の面１１５ａがアース基板１２２に押当てられ、幅Ｗ２の領域内で下側の面１１５ｂが熱伝導性粘着層１１３を介し電気導体１２１に止められている。

【００３９】

熱伝導性粘着層１１３は、クッション本体１１１の段差部１１１ｂが形成された予め設定した下側面１１１ｂに設けられ、幅Ｗ３の領域で電気導体１２１に当接し止められている。そのため、クッション本体１１１は、熱伝導性粘着層１１３が設けられていない幅Ｗ４の領域で電気導体１２１に押し当てられている。

【００４０】

10

20

30

40

50

導電フィルム 114 は、クッション本体 111 の上側の面 115 a に設けられた粘着層 112 と、粘着層 112 と対向する熱伝導性粘着層 113 の幅 W1 の領域と、クッション本体 111 の一方の端部側の側面 115 c とを折曲げられて連続して覆い貼り付けられている。

【0041】

領域の幅 W1 は、上側の面 115 a でも下側の面 115 b でも導電フィルム 114 の幅を示し、領域の幅 W2 は、上側の面 115 a ではクッション本体 111 がアース基板 122 に押当てられる幅を示し、下側の面 115 b でもクッション本体 111 が熱伝導性粘着層 13 を介し電気導体 21 に止められる領域の幅 W3 とクッション本体 111 が電気導体 121 に押当てられる領域の幅 W4 との幅を示し、領域の幅 W1 と領域の幅 W2 とを同じ幅に設定しているが、領域の幅 W1 と領域の W2 とは、導電フィルム 114 の導電性や熱伝導性粘着層 113 の粘着性や熱伝導性により自在に設定することもできる。また、領域の幅 W3 と領域の幅 W4 も自在に設定することができる。

10

【0042】

導電伝熱ガスケット 110 は、上記したごとく導電フィルム 114 がクッション本体 111 に折曲げられて連続して覆い貼り付けられ、電気導体 121 とアース基板 122 との間の隙間に電氣的に導通して設けられ、電気導体 121 とアース基板 122 との間の隙間に変動があったとしても電氣的な導通性が損なわれることはない。

【0043】

また、導電伝熱ガスケット 110 は、電気導体 21 にコイルや CPU などの発熱体 123 が設けられていたときには、その熱は、矢印 R1 に示すように熱伝導性粘着層 113 を介しクッション本体 111 によりアース基板 122 に伝達されるとともに、矢印 R2 に示すように、直接クッション本体 111 によりアース基板 122 に伝達され、熱伝導性粘着層 113 により電気導体 121 への保持機能を維持し放熱をより効果的に行なうことができる。

20

【0044】

以上、本発明の第 2 の実施の形態の導電伝熱ガスケットは、電子関連製品において電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱性の機能を備え、小型電子部品の放熱効果を効果的に得ることができる。

30

【0045】

なお、導電伝熱ガスケット 110 のそれぞれの構成部は、本発明の第 1 の実施の形態の導電伝熱ガスケット 10 と同じ機能を備えている。

【0046】

さらに、クッション本体 111 は、上側の面 115 a に段差部 111 a が形成され、下側の面 115 b に段差部 111 b が形成されているが、導電フィルム 114、粘着層 112、熱伝導性粘着層 113 の状況により平面状にすることもできる。

【実施例 3】

【0047】

図 3 は、本発明の第 3 の実施の形態の導電伝熱ガスケットの断面図を示す。

40

【0048】

図 3 に示すように、本発明の第 3 の実施の形態の導電伝熱ガスケット 210 は、小型電子部品でもある電気導体 221 とアース基板 222 との間の隙間に設けられ、電気導体 221 とアース基板 222 との間に圧縮され保持されている。

【0049】

導電伝熱ガスケット 210 は、放熱ゲルで形成されクッション性と粘着性のあるクッション本体 211 と、クッション本体 211 の特定部を覆う導電フィルム 214 とで構成され、電気導体 221 とアース基板 222 との間の隙間に圧縮され保持されている。

【0050】

導電フィルム 214 は、クッション本体 211 の上側の面 215 a と、クッション本体

50

２１１の下側の面２１５ｂと、クッション本体２１１の一方の端部側の側面２１５ｃとを折曲げられて連続して覆い貼り付けられている。

【００５１】

領域の幅Ｗ１は、上側の面２１５ａでも下側の面２１５ｂでも導電フィルム２１４の幅を示し、領域の幅Ｗ２は、上側の面２１５ａではクッション本体２１１がアース基板２２２に押当てられる幅を示し、下側の面２１５ｂでもクッション本体２１１が電気導体２２１に押当てられる領域の幅を示し、領域の幅Ｗ１と領域の幅Ｗ２とを同じ幅に設定しているが、領域の幅Ｗ１と領域の幅Ｗ２とは、導電フィルム２１４の導電性や熱伝導性により自在に設定することもできる。

【００５２】

導電伝熱ガスケット２１０は、上記したごとく導電フィルム２１４が上側の面２１５ａで段差部２１１ａが形成され下側の面２１５ｂで段差部２１１ｂが形成されたクッション本体２１１に折曲げられて連続して覆い貼り付けられ、電気導体２２１とアース基板２２２との間の隙間に電氣的に導通して設けられ、電気導体２２１とアース基板２２２との間の隙間に変動があったとしても電氣的な導通性が損なわれることはない。

【００５３】

また、導電伝熱ガスケット２１０は、電気導体２２１にコイルやＣＰＵなどの発熱体２２３が設けられていたときには、その熱は、矢印Ｒに示すようにクッション本体２１１によりアース基板２２２に伝達され、放熱ゲルで形成されたクッション本体２１１に粘着性があるためアース基板２２２と電気導体２２１への保持機能を維持し放熱を簡潔構造で効果的に行なうことができる。

【００５４】

以上、本発明の第３の実施の形態の導電伝熱ガスケットは、電子関連製品において電気導体間の隙間や電気導体とアース基板間の隙間にクッション性を持たせ電氣的に安定して導通すると共に放熱性の機能を備え、小型電子部品の放熱効果を効果的に得ることができる。

【００５５】

なお、導電伝熱ガスケット２１０は、クッション本体２１１を放熱ゲルで形成することとしたが、これに限定されることなくゴムなども含めた自己粘着性を有するクッション材で形成することができる。また、クッション本体２１１は、上側の面２１５ａか下側の面２１５ｂかのいずれかの片面のみに自己粘着性を有する部材を使用することができる。その場合、自己粘着性を有しない面には粘着層または熱伝導性粘着層を備えるようにする必要がある。

【００５６】

また、クッション本体２１１は、上側の面２１５ａに段差部２１１ａが形成され、下側の面２１５ｂに段差部２１１ｂが形成されているが、平面状にすることもできる。

【００５７】

さらに、本発明の第１、２、３の実施の形態の導電伝熱ガスケットは、導電フィルムを導電体として使用することとしたが、これに限定することなく導電性の布なども導電体として使用することができる。

【産業上の利用可能性】

【００５８】

本発明の導電伝熱ガスケットは、携帯電話やパソコンなどに限らず各種の電気製品に適用することができる。

【符号の説明】

【００５９】

- １０、１１０、２１０ 導電伝熱ガスケット
- １１、１１１、２１１ クッション本体
- １２、１１２、２１２ 粘着層
- １３、１１３ 熱伝導性粘着層

10

20

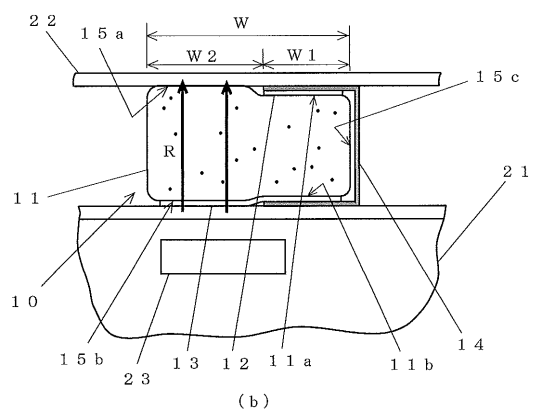
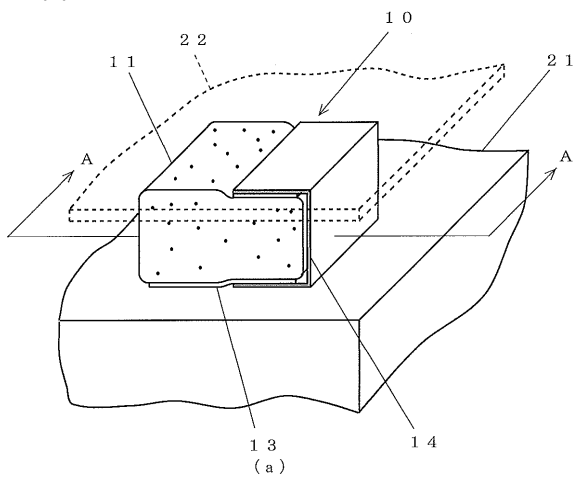
30

40

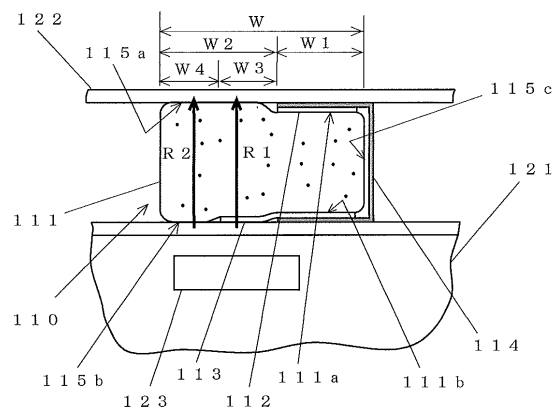
50

2 1、1 2 1、2 2 1 電気導体
 2 2、1 2 2、2 2 2 アース基板
 1 4、1 1 4、2 1 4 導電フィルム

【図 1】



【図 2】



【図 3】

